



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203726036 U

(45) 授权公告日 2014. 07. 23

(21) 申请号 201320855528. 8

(22) 申请日 2013. 12. 23

(73) 专利权人 天通精电新科技有限公司

地址 314000 浙江省嘉兴市南湖区亚太路 1 号

(72) 发明人 李明锁 刘水波

(51) Int. Cl.

B23K 37/04 (2006. 01)

B23K 3/08 (2006. 01)

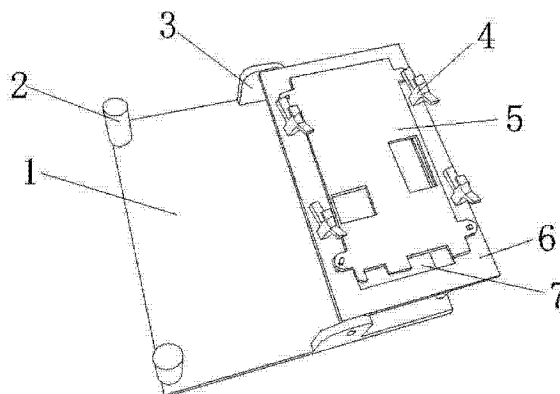
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种 SMT 回流焊夹具

(57) 摘要

本实用新型公开了一种 SMT 回流焊夹具, 包括底板, 其特征在于所述的底板的中间两侧设置底座, 所述的底座之间设置翻板, 所述的翻板上设置卡扣, 本实用新型所述的一种 SMT 回流焊夹具, 方便正反两面进行回流焊操作, 结构简单, 使用方便。



1. 一种 SMT 回流焊夹具,包括底板(1),其特征在于:所述的底板(1)的中间两侧设置底座(3),所述的底座(3)之间设置翻板(6),所述的翻板(6)上设置卡扣(4)。
2. 根据权利要求 1 所述的一种 SMT 回流焊夹具,其特征在于所述的底座(3)上设置与翻板(6)两端凸起配合的圆孔。
3. 根据权利要求 1 所述的一种 SMT 回流焊夹具,其特征在于所述的底板(1)的四个角上设置圆柱(2)。
4. 根据权利要求 1 所述的一种 SMT 回流焊夹具,其特征在于所述的翻板(6)上设置矩形孔(7)。
5. 根据权利要求 4 所述的一种 SMT 回流焊夹具,其特征在于所述的矩形孔(7)处安装电路板(5)。
6. 根据权利要求 1 或 5 所述的一种 SMT 回流焊夹具,其特征在于所述的电路板(5)通过卡扣(4)锁紧。
7. 根据权利要求 1 所述的一种 SMT 回流焊夹具,其特征在于所述的卡扣(4)两边设置高度不等的凸起。

一种 SMT 回流焊夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及 SMT 技术领域,具体涉及一种 SMT 回流焊夹具。

背景技术

[0002] SMT 是电子电路表面组装技术(表面贴装技术, Surface Mounted Technology 的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺,是一种将无引脚或短引线表面组装元器件(简称 SMC/SMD,中文称片状元器件)安装在印制电路板(Printed Circuit Board,简称 PCB)的表面或其它基板的表面上,通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术,其特点是组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的 1/10 左右,一般采用 SMT 之后,电子产品体积缩小 40%~60%,重量减轻 60%~80%,可靠性高、抗震能力强,焊点缺陷率低,高频特性好,减少了电磁和射频干扰。易于实现自动化,提高生产效率,降低成本达 30%~50%,节省材料、能源、设备、人力、时间等。目前在进行回流焊操作时,当焊接完一面,需要将电路板拆下来翻转后再重新安装到夹具上进行另一面的焊接,十分麻烦、效率低。

发明内容

[0003] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案是:

[0004] 一种 SMT 回流焊夹具,包括底板,其特征在于所述的底板的中间两侧设置底座,所述的底座之间设置翻板,所述的翻板上设置卡扣。

[0005] 作为优选,所述的底座上设置与翻板两端凸起配合的圆孔。

[0006] 作为优选,所述的底板的四个角上设置圆柱。

[0007] 作为优选,所述的翻板上设置矩形孔。

[0008] 作为优选,所述的矩形孔处安装电路板。

[0009] 作为优选,所述的电路板通过卡扣锁紧。

[0010] 作为优选,所述的卡扣两边设置高度不等的凸起。

[0011] 本实用新型所述的一种 SMT 回流焊夹具具,弥补了现有技术的不足,结构简单、使用方便、提高了焊接效率。

附图说明

[0012] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和实例对本实用新型做进一步说明。

[0014] 如图所示,一种 SMT 回流焊夹具,包括底板 1,其特征在于:所述的底板 1 的中间两侧设置底座 3,所述的底座 3 之间设置翻板 6,所述的翻板 6 上设置卡扣 4,所述的底座 3 上设置与翻板 6 两端凸起配合的圆孔,所述的底板 1 的四个角上设置圆柱 2,所述的翻板 6 上

设置矩形孔 7,所述的矩形孔 7 处安装电路板 5,所述的电路板 5 通过卡扣 4 锁紧,所述的卡扣 4 两边设置高度不等的凸起。

[0015] 实际使用时,将需要焊接的电路板安装到翻板上,并通过卡扣锁紧,卡扣两边设置高度不等的凸起,可根据电路板的厚度选择使用,锁紧后先进行一面的焊接,完成后直接将翻板翻转过来再进行另一面的焊接,小圆柱用于支撑翻板,本实用新型所述的一种 SMT 回流焊夹具,弥补了现有技术的不足,结构简单、使用方便、提高了焊接效率。

[0016] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均包含在本实用新型的保护范围之内。

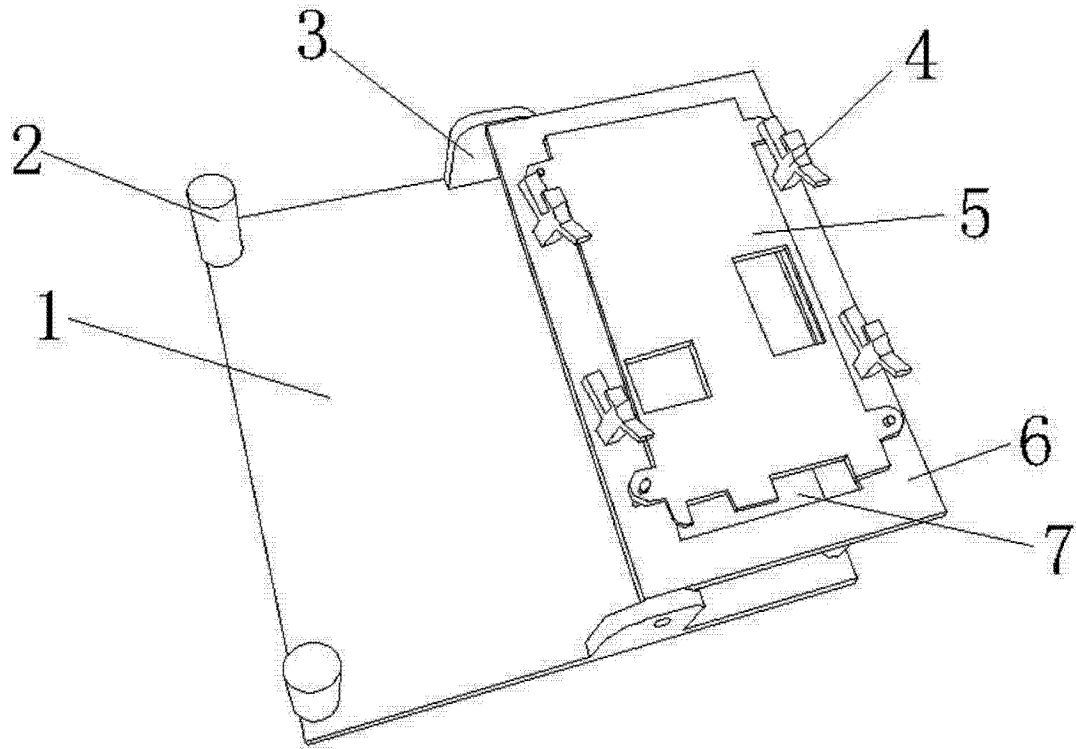


图 1